

## WLCSP

2005年6月, 苏州晶方半导体科技股份有限公司 (SSE : 603005) 成立于苏州, 是一家致力于开发与创新新技术, 为客户提供可靠的, 小型化, 高性能和高性价比的半导体封装量产服务商。晶方科技的CMOS影像传感器晶圆级封装技术, 彻底改变了封装的世界, 使高性能, 小型化的手机相机模块成为可能。这一价值已经使之成为有史以来应用广泛的封装技术, 现今已有近50%的影像传感器芯片可使用此技术, 大量应用于智能电话, 平板电脑, 可穿戴电子等各类电子产品。公司及子公司Optiz Inc. (位于Palo Alto, 加州) 将持续专注于技术创新。

近十年来, 晶方科技已经成为技术开发与创新、提供优质量产服务的领军者。随着公司不断发展壮大, 公司设立美国子公司Optiz Inc., 是在影像传感器微型化的增强与分析领域的领军者; 购买智瑞达资产, 是新一代半导体封装技术的创新者。

晶方科技的使命是创新和发展半导体的互连和成像技术, 为公司的客户、合作伙伴、员工和股东创造价值。晶方科技全球员工将近2000人, 工程师和科学家大约400人, 其中超过50%拥有高等学位。

本文链接 : <https://dqcm.net/wenan/wlcsp-802130.html>